

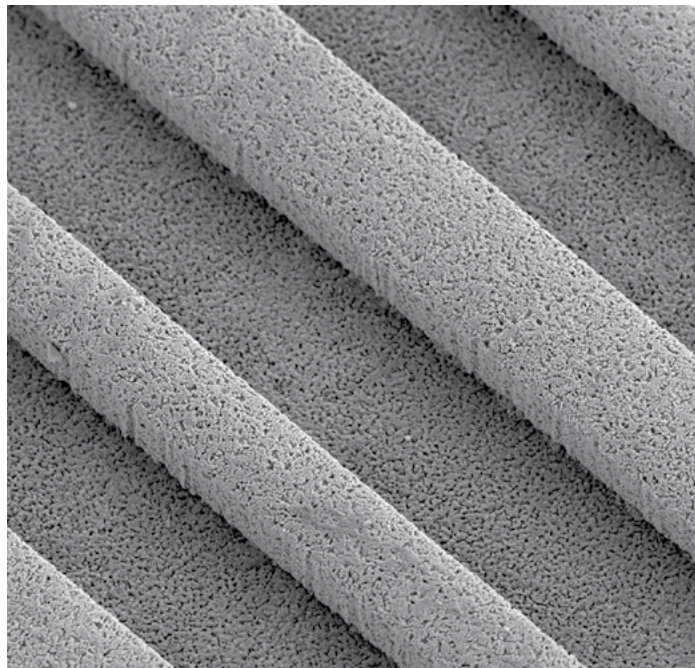
M-Speed HF

高频内层铜前处理

高速、高频应用无上限

M-Speed HF 是专为满足下一代高速数据传输要求而开发的一种替代黑氧化制程。展现出麦德美阿尔发公司在低蚀刻技术的可靠性。有效的减少讯号损失和提高附着力。独特的低蚀刻制程提供了低粗糙度表面形貌，以优化高速产品的最大讯号完整性。尽管峰谷粗糙度较低，但 M-Speed HF 制程仍可提供卓越的附着力和热应力可靠性。

M-Speed HF 利用标准棕化制程设备与新型后浸制程相结合，实现了行业领先的性能。该制程与几乎所有层压材料兼容，并对低损耗和超低损耗介电材料产生出色的附着力。要应对下一代高速高频设计的产品，请选择 M-Speed HF。



主要特性优点

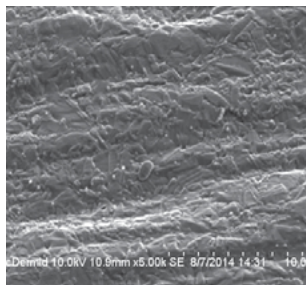
- 降低铜粗糙度，减少信号损失
- 精确的蚀刻速率，实现低阻抗设计
- 环保 - 减少化学品消耗和浪费
- 优异的可靠性，适用于多层板设计



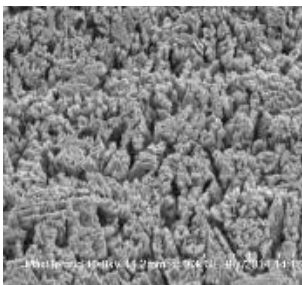
M-Speed HF

高频内层铜前处理

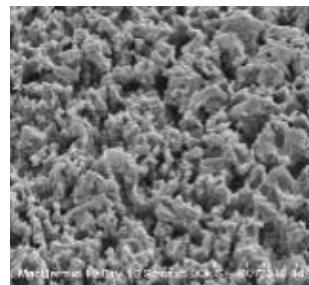
高频电路板应用制程



应用 M-Speed 前



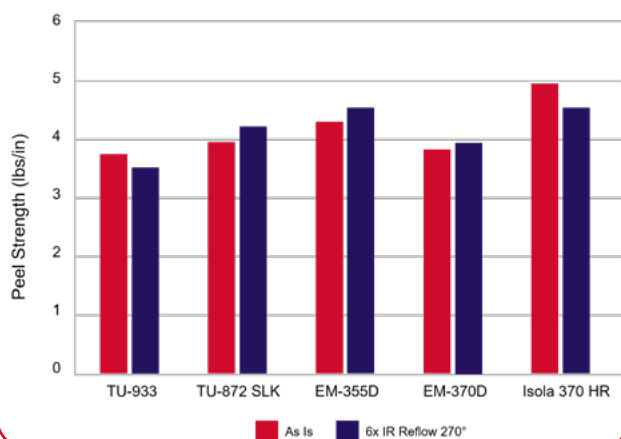
应用 M-Speed HF 后



替代氧化比较

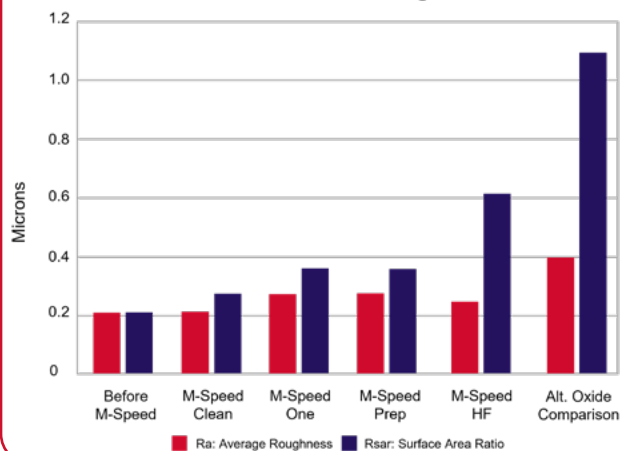
拉力

M-Speed HF Adhesion on Low Loss Materials



表面粗糙度

ZYGO Surface Roughness



M-Speed 清洗

M-Speed HF
预浸

M-Speed HF

M-Speed HF
后浸

清洗和烘干

